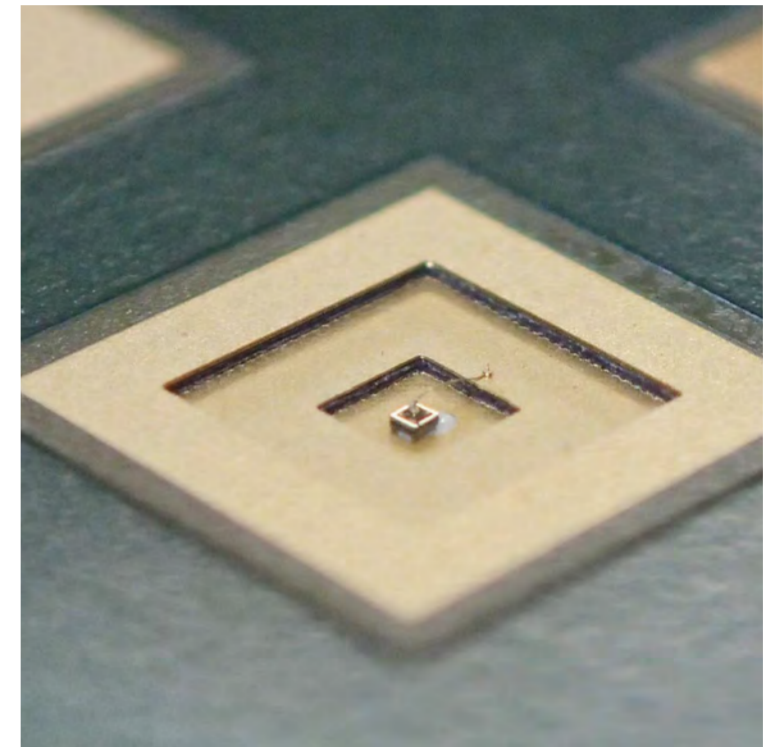
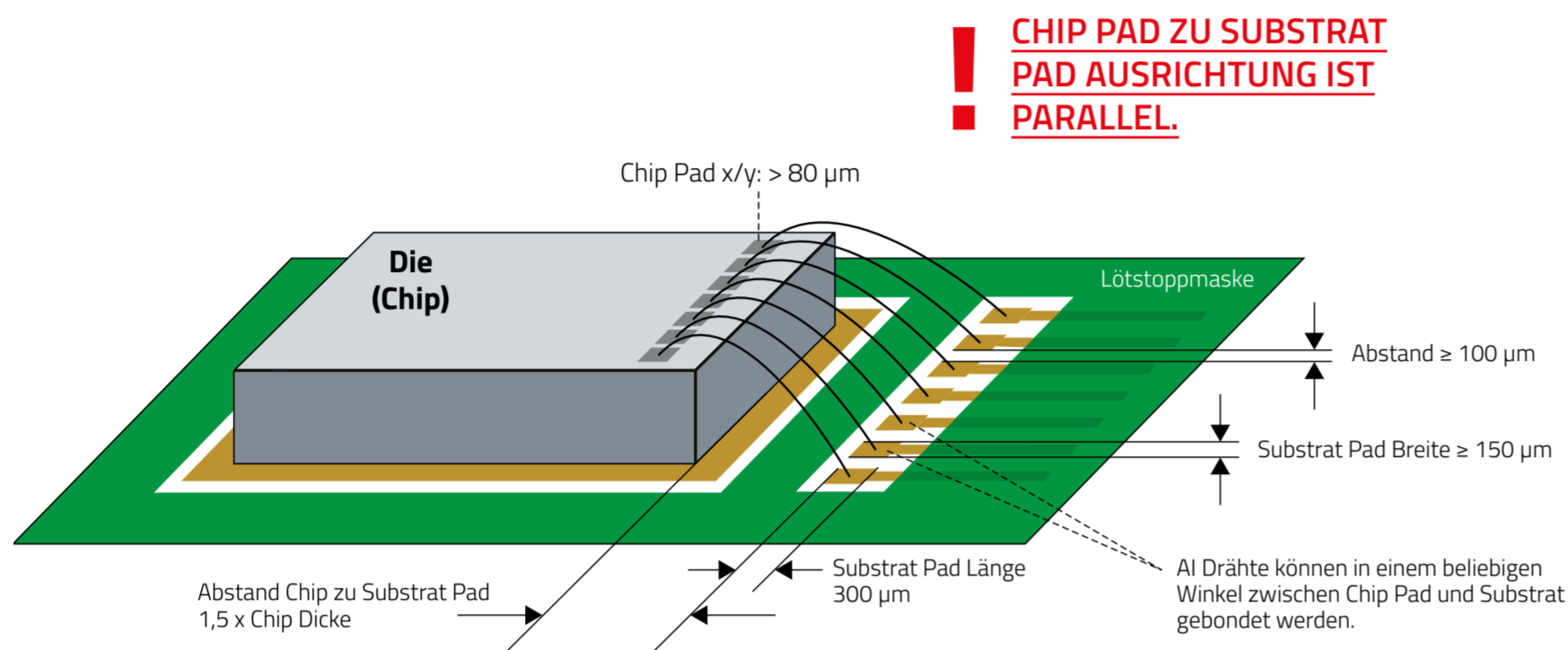


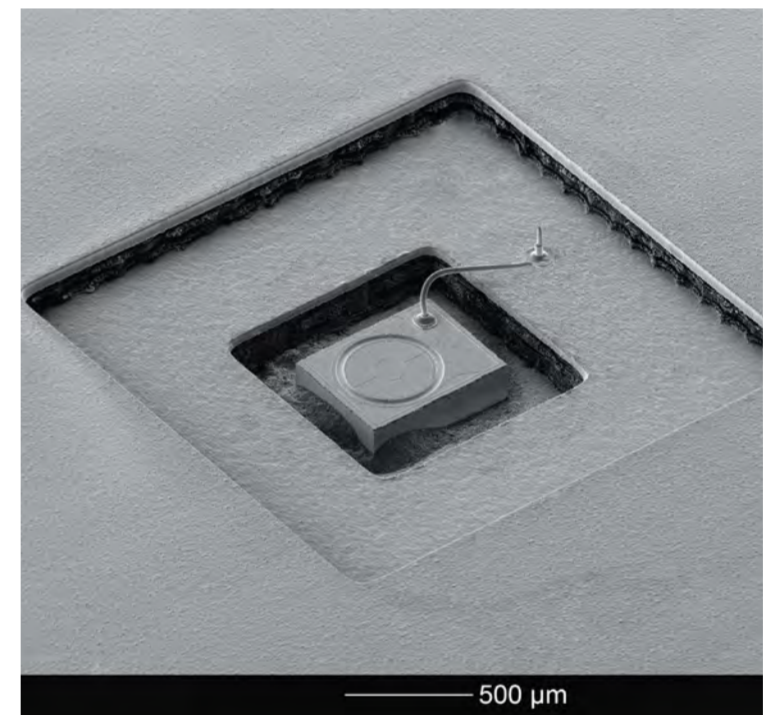
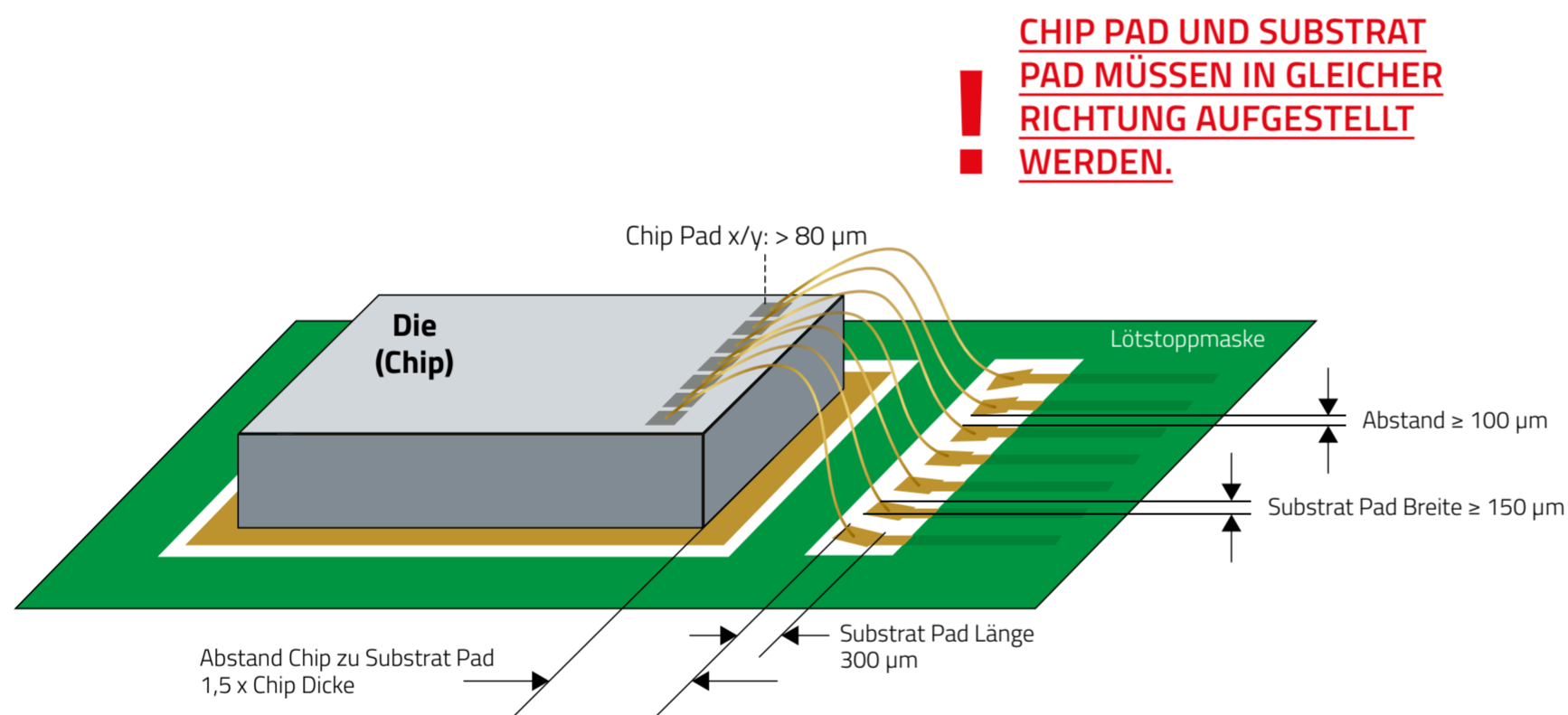
CHIP ON BOARD / DRAHTBONDEN

Designregeln für Aluminium (Al) Drahtbonden



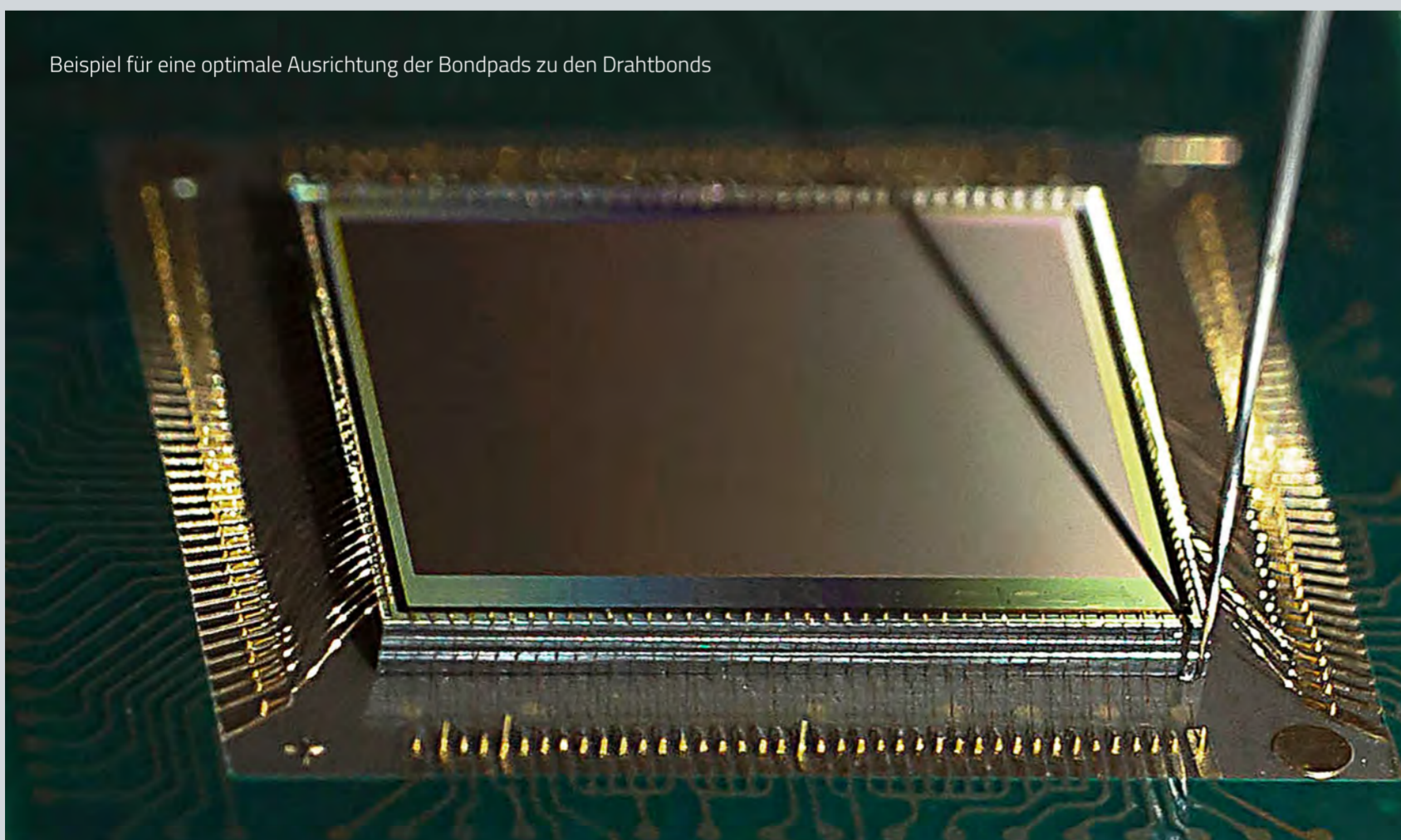
Drahtgebondete Diode in einer mehrstufigen Lasercavity

Designregeln für Gold (Au) Drahtbonden



REM-Vergrößerung einer drahtgebondeten Diode in mehrstufiger Lasercavity

Beispiel für eine optimale Ausrichtung der Bondpads zu den Drahtbonds



! IM BEREICH DER DRAHTBONDPADS MUSS DIE LÖTSTOPP-MASKE IM BLOCK FREIGESTELLT WERDEN!

MORE SUPPORT THAN YOU EXPECT

wirebonding@we-online.com

Sie haben Fragen zu Fertigungsdaten, Toleranzen, Prüfdokumentation oder Verpackung? In unserer Technischen Lieferspezifikation für Leiterplatten (TLS) finden Sie unsere Standards und Empfehlungen für eine reibungslose und effektive Zusammenarbeit.